

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A foreign object having a larger thickness than the conductor width existing under the dry film prevents adhesion of the dry film, causing etching of conductor. (Dry film lamination - etching process)



【コメント】

FPC

【注釋】

FPC

【Comments】

FPC

1-1-1-10 糊残り断線／胶迹的开路 / Open caused by residual adhesive

【特徴】 導体面の凹凸を伴ったイレギュラ形状の断線で、突起や短絡等と混在しているケースが多い

【特征】 沿着导线面的凹凸而不规则的开路，多数是凸出和短路等并存。

【Characteristics】 An irregular-shaped open accompanied with surface roughness of the conductor. It often occurs together with conductor protrusions and shorts.

【原因・判断ポイント・発生工程】 積層板表面に厚めの糊がイレギュラに付着したまま銅めっきされた凹凸表面が、ラミネート前の研磨工程で平滑に研磨しきれないまま、ラミネートされ、DFRが密着しなかったことにより、ET液に食われて出来たもの（めっき前～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】 层压板表面不规则地附着较厚的胶，镀铜后表面凹凸，在研磨工序没有磨平就进行压膜，导致DFR压合不紧，被ET液腐蚀而引起的（电镀前～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Copper plating is made on the base laminate surface where some thick adhesive remain irregularly that are not completely removed at abrasion process prior to dry film lamination. Poor adhesion of the dry film results in conductor etching of conductor. (Plating surface preparation - etching process)



【コメント】

顕微鏡倍率×100

【注釋】

显微镜倍率×100

【Comments】

Magnification: ×100



【コメント】

顕微鏡倍率×

【注釋】

显微镜倍率×

【Comments】

Magnification: ×